

## INVESTOR RELATIONS

2022년

Your Most trustworthy



## 유의사항 [Disclaimer]

본 자료는 한국채택국제회계기준 연결실적에 대한 경영실적 및 재무성과를 바탕으로 작성되었습니다.

또한 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있으며, 이러한 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 불확실성으로 인하여, 실제 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

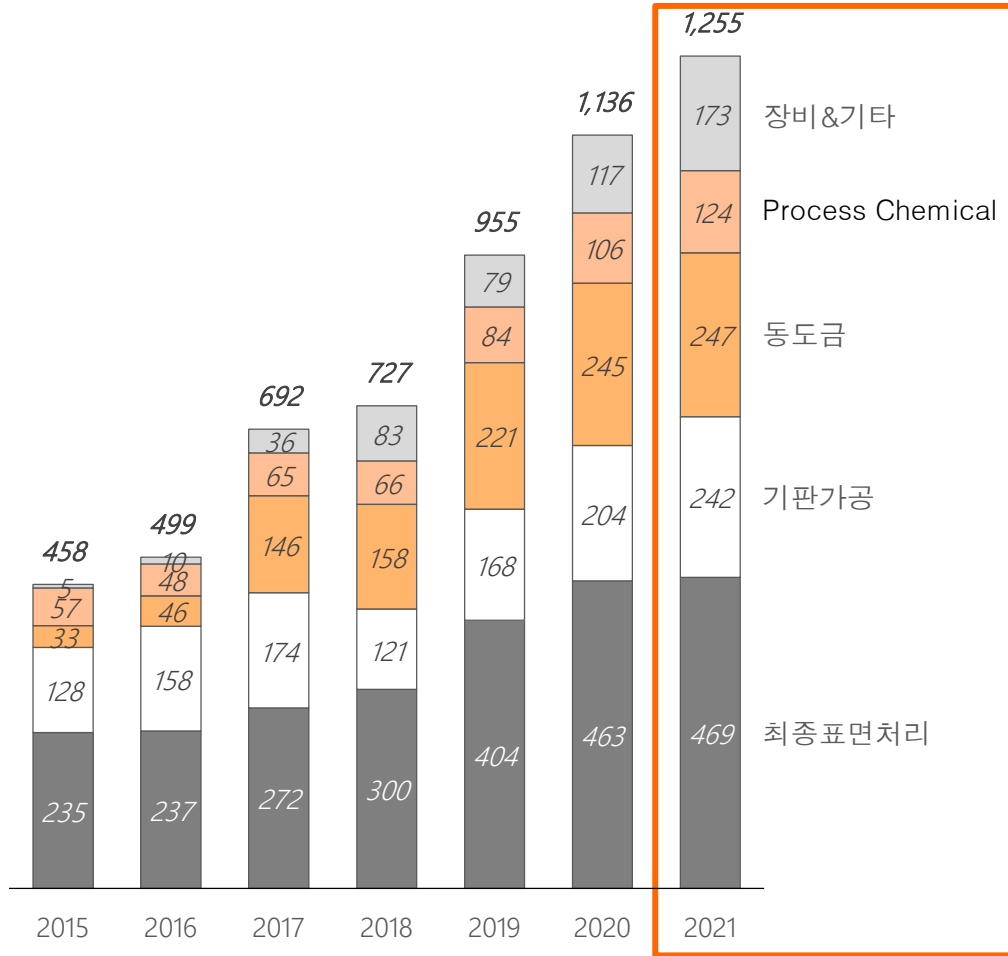
- 국내외 국가정책변경에 따른 세율 변동 (FTA, 관세, 법인세 등)
- 환율 및 이자 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향
- 주요 매출시장의 환경의 예상치 못한 급격한 변화
- 회사내의 전략적인 의사결정

이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과는 중대한 차이가 있을 수 있습니다.



Sales Result

■ 최종표면처리 □ 기판가공 ■ 동도금 ■ Process Chemical □ 기타 및 장비 (단위:억원)



- 21년 누적 매출액 1,255억원으로 역대 최대 매출 달성
  - ✓ 20년 대비 120억원 / 10.59% 성장
- Chemical 제품군의 지속적인 성장
  - ✓ Process Chemical : Substrate PKG 고객사 진입으로 인한 전년 대비 매출 상승
- 베트남 법인의 매출 및 이익 확대
  - ✓ 20년 255.9억원 → 21년 328.4억원 / 28.33% 성장
  - ✓ 국내 FPCB 고객사의 물량이 베트남으로 이전됨에 따라 베트남 법인의 약품 매출 확대
  - ✓ 베트남 법인 도금사업부 기판가공 매출실적 확대

Income Statement

(단위:억원)

	제 23기	매출비중	제 22기	매출비중
I. 매출액	1,255.7	100%	1,135.5	100%
II. 매출원가	890.3	70.9%	742.4	65.4%
III. 매출총이익	365.4	29.1%	393.1	34.6%
판매비와 관리비	193.1	15.4%	158.2	13.9%
IV. 영업이익	172.3	13.7%	234.9	20.7%
금융수익	54.5	4.3%	40.6	3.6%
금융비용	59.0	4.7%	58.5	5.2%
기타수익	12.5	1.0%	6.2	0.5%
기타비용	16.4	1.3%	3.6	0.3%
지분법손익	0.0	0.0%	(1.4)	-0.1%
V. 법인세차감전순이익	163.9	13.1%	218.2	19.2%
법인세비용	23.5	1.9%	20.5	1.8%
VI. 당기순이익	140.4	11.2%	197.7	17.4%

주요 수익성 지표

	23기	22기
영업이익률	13.7%	20.7%
순이익률	11.2%	17.4%
EBIT	168.4	236.1
EBITDA (마진율)	240.8 (19.18%)	294.8 (25.97%)
ROE	9.1%	15.9%
총자산회전률	56.5%	62.7%

## Balance Sheet

(단위:억원)

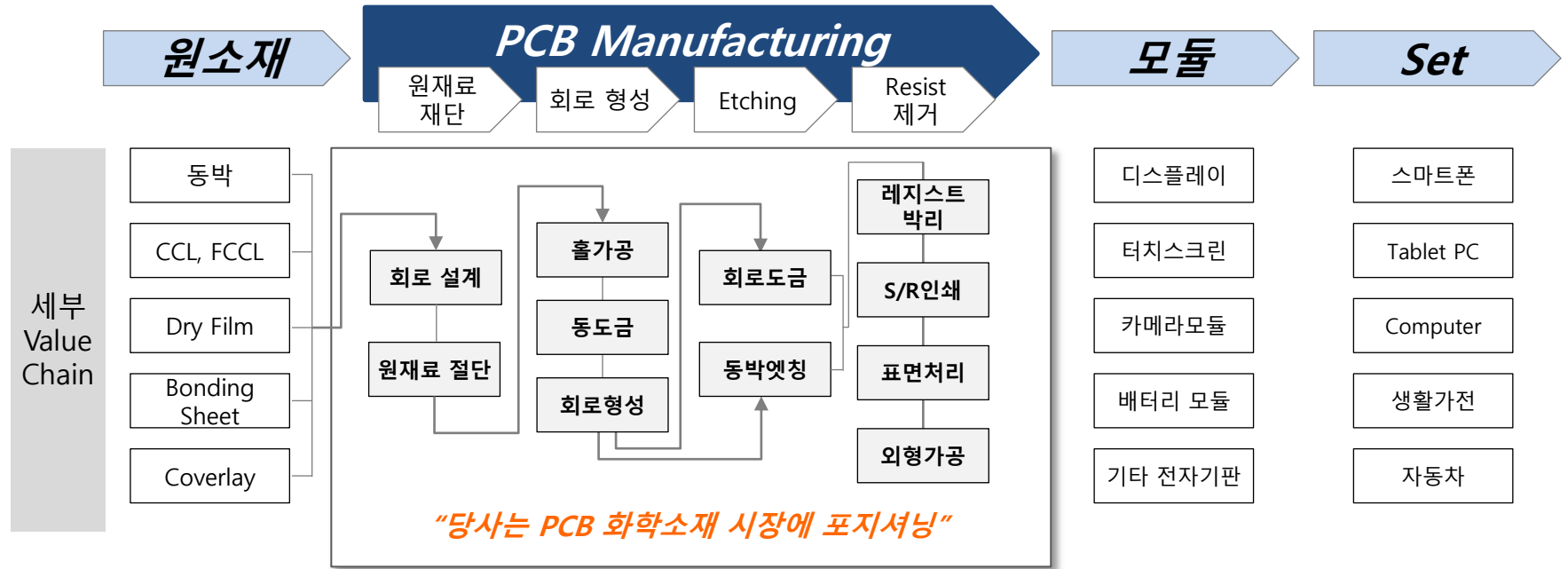
	제 23기	제 22기
자산		
현금성자산	701.9	556.4
매출채권	260.9	266.0
유형자산	955.3	769.5
기타자산	544.5	392.7
<b>자산총계</b>	<b>2,462.6</b>	<b>1,984.6</b>
부채		
매입채무	36.9	34.2
차입금	682.5	496.3
전환사채	95.2	122.1
기타부채	254.4	151.5
<b>부채총계</b>	<b>1,069.0</b>	<b>804.1</b>
자본		
자본금	74.8	74.8
자본잉여금	249.4	249.4
이익잉여금	768.9	674.8
기타자본	300.5	181.5
<b>자본총계</b>	<b>1,393.6</b>	<b>1,180.5</b>
부채와 자본계	2,462.6	1,984.6

## Cash Flow

(단위:억원)

	제 23기	제 22기
기초현금	556.4	417.5
영업활동으로 인한 현금흐름	224.1	244.1
당기순이익	140.4	197.7
감가상각비	68.5	60.0
이자비용	22.6	18.6
파생상품평가손실	25.9	0.0
기타	(33.3)	(32.2)
투자활동으로 인한 현금흐름	(261.5)	(249.7)
유형자산의 취득(처분)	(227.1)	(216.4)
기타	(34.4)	(33.3)
재무활동으로 인한 현금흐름	135.2	165.7
차입금 증감	171.2	151.6
전환사채의 상환	(40.0)	0.0
기타	4.0	14.1
현금증감	97.8	160.1
환율변동효과	47.7	(21.2)
기말현금	701.9	556.4

PCB Industry value chain

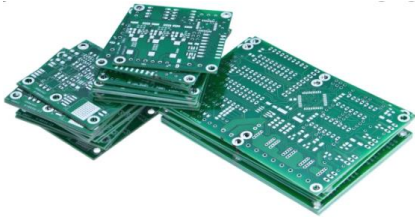


당사의 주요 포지셔닝은 PCB 화학소재이며 특히 부가가치가 높은 최종표면처리 및 화학동도금 Segment에서 주요 매출이 발생되고 있습니다.

PCB Industry

**PCB : Printed Circuit Board의 약자로 인쇄회로기판을 의미**

구리 배선이 가늘게 인쇄된 판으로, 반도체, 컨덴서, 저항 등 각종 부품을 실장 할 수 있게 되어있으며 부품 상호간의 연결구실을 하는 모듈



**RIGID PCB**

RIGID 즉, 경성화 된 일반적인 PCB



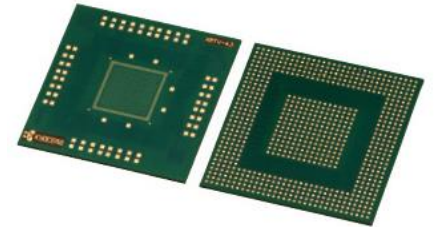
**HDI**

고밀도인쇄회로기판 (주로 휴대폰 메인기판)



**FPCB / RFPCB**

FCCL을 사용하여 휘어지는 특성을 가지는 PCB



**PKG Substrate**

반도체 실장용 PCB

**BGA, FC-BGA, CSP 등**

주요고객사 (Major Customer)

*“주로 한국, 중국, 대만의 FPCB 회사들이 주요 고객사이며, 최근 한국의 PKG Substrate 제조사로 고객사 확대중”*

FPCB Customer				
				
				
PKG Substrate				



## Total Solution for Customer

와이엠티는 공정의 첫 단계인 세정, 박리제 부터 최종 표면처리 까지의 모든 화학소재 기술을 보유하고 있습니다. 이에 저희는 고객사 설비 특성에 맞는 Total chemical solution을 제공하고 있습니다.



### Final Finishing Chemical

#### **Soft ENIG Process**

- ✓ CF 300 Series
- ✓ MIKO Series

#### **ENIG Process**

- ✓ PEN Series
- ✓ MIKO Series

#### **ENEPIG Process**

- ✓ PEN Series
- ✓ ELP or ZEP Series
- ✓ IR Gold Series

#### **EPIG process**

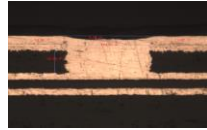
- ✓ ZEP Series
- ✓ IR Gold Series

#### **Immersion process**

- ✓ PROTIN Series

#### **Electrolytic gold process**

- ✓ HG 300 series
- ✓ SAU 10 series



### Copper plating chemical

#### **Electroless Copper plating**

- ✓ HVF Series
- ✓ MJH series

#### **Electrolytic Copper plating**

- ✓ BJ series
- ✓ HBJ Series(Half-fill)
- ✓ FSBJ Series(flash plating)
- ✓ ZEUS Series(Via-fill)



### Process Chemical

#### **DES Chemical**

- ✓ MSAP/SAP DFR Stripper
- ✓ MSAP/SAP Cu seed Etchant
- ✓ GMZ Series
- ✓ HWA Series

#### **Cleaner**

- ✓ FXC Series
- ✓ EQ Series

#### **Gold Recover**

#### **UBM Etchant**

#### **LAZ Process**



### New product for 5G

#### **No etching and roughness laminating pretreatment**

#### **Ultra low profile detachable thin copper foil**

#### **Positive Cu roughening**

#### **Process Nanotus®**

#### **Electroless Copper plating for LCP**

Domestic Market situation

신규 사업분야  
기존 사업분야

		"기존 사업영역" FPCB, RFPCB		"22년 신규진입분야" PKG		HDI		RIGID	
Major player	Domestic	<ul style="list-style-type: none"> <li>SEMCO</li> <li>BH Flex</li> <li>Youngpoong</li> <li>Daeduck</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SEMCO</li> <li>Daeduck</li> <li>SIMTECH</li> <li>Korea Circuit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daeduck</li> <li>LG Innoteck</li> <li>Korea Circuit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hyunwoo</li> <li>SEIL</li> </ul>				
	Global	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zhending Technology</li> <li>Career</li> <li>Unimicron</li> <li>Mektron</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AT&amp;S</li> <li>Zhending Technology</li> <li>Ibiden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AT&amp;S</li> <li>Zhending Technology</li> <li>Ibiden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Various</li> </ul>				
Process Chemical		<ul style="list-style-type: none"> <li>점유율 확대중</li> <li>Fine pattern 용 고부가가치 박리액 등 프로모션</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>고객사 및 라인 확대중</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>박리 / 에칭 관련 매출 확대중</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>				
Cu Plating	Electroless	<ul style="list-style-type: none"> <li>국내 높은수준의 점유율 보유 (40% 이상 추정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>심택, TLB 등 업체에 공급</li> <li>올해 다수의 PKG 업체에 공급될 전망</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>국내 HDI 업체 프로모션 중</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>				
	Electro	<ul style="list-style-type: none"> <li>외주를 통한 양산</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>현재 자회사 외주를 통한 매출발생중</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Developing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>				
최종표면처리	Electroless	<ul style="list-style-type: none"> <li>금도금 분야 전세계 1위 점유율 확보 (50%이상)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>고객사 평가중</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Developing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>일부 국내 고객사 거래중</li> </ul>				
	Electro	<ul style="list-style-type: none"> <li>베트남 시장 전해금도금 외주물량 확대</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Developing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Developing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Developing</li> </ul>				

원재료 가격 폭등에 따른 와이엠티의 현 상황은 어떠한가?

**팔라듐 (Palladium)**

- 팔라듐은 LME 시세로 연동하여 판매하기 때문에 고객사로 가격이 전가되는 구조.
- 당사는 금융상품을 통한 헷지 보다는 매일매일 소량을 분산 구매하는 방식으로 대응중임
- 이로 영업이익의 절대 액은 지킬 수 있으나, 팔라듐 가격이 높아질수록 영업이익률은 하락

**니켈, 구리**

- 연동하지 않고 있으나, 두 원재료 모두 가격 폭등으로 향후 가격인상 및 연동제를 고려중임
- 팔라듐 처럼 사용량이 많은 제품이 아니기 때문에 이익 훼손 규모는 제한적

매출 상승에도 마진율이 감소이유는?

**1. 반도체 공급부족으로 인한 제품생산량 감소**

- 3분기 중국법인 매출 역신장, 반도체 공급부족으로 아이폰, 아이패드 생산량 감소
- 11~12개의 FPCB가 사용되는 바, OLED용 RFPCB는 정상적으로 공급되었으나 현지에서 수급하는 나머지 FPCB들은 생산량에 맞추어 생산되는데 반도체 공급부족으로 인해 감소

**2. 원재료 가격 상승 및 귀금속 상품 판매 확대**

- 팔라듐 등의 귀금속 원재료 상승 및 석유화학관련 제품의 가격상승으로 전반적인 원재료비 상승
- 마진율 1%의 귀금속(상품)의 매출 확대

**3. 인건비 상승**

- 동박 관련 신규 석,박사 인력 확대
- 자회사인 키미랩 인원확충
- 자회사 에스피머티리얼즈 인원 확대

## 중국공장 (주하이)

- 현재 중국법인은 금도금 제품만 시장에 판매중으로 공장 건설 후, 동도금을 비롯한 기타 약품을 현지제조, 판매 예정
- 현재 완공되었으며 현재 환경 및 고객사 Audit 중
- 올해 기판가공 사업에 대한 추가 투자 예정이며, 중국의 카메라 모듈 기판가공 시장이 가장 큰만큼 당사의 매출 및 수익에 긍정적인 영향

## 송도공장

- 현재 4000평 부지를 인천시로 부터 분양 받아 올해 착공 예정
- 남동공단에 총 4개의 필지를 사용하는 바, 연구소의 통합과 바이오 원단 생산라인, 동박 Pilot 라인등으로 사용될 예정이며, 이를 통해 부지 효율화 작업을 계획하고 있음

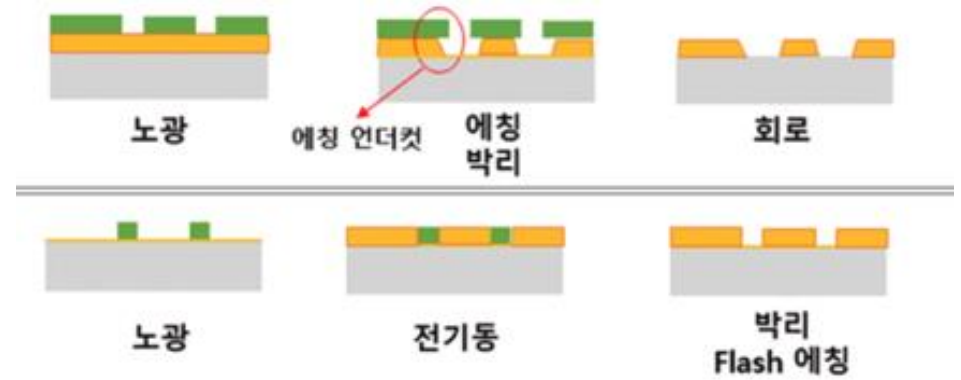
## 신규사업

- 동박 : 국책과제 진행중으로 빠르면 올해 양산 가능한 수준으로 연간 200억원 수준의 Capa는 Set-up 완료
- 구리원단 : 현 마스크로 월 3~4억원 수준의 매출 발생. 현재 글로벌 TOP 골프브랜드와 모자, 깔창등 제품 적용 협의중
- 바이오사업 : 금속을사용한 특수부대 시장에 진출, 현재 대학병원과 함께 성능테스트 및 인증절차 준비중.으로 올해 임상 예정

신규사업 동박 (Ultra-thin copper foil)

극동박 시장의 성장 이유

- 기존 공법은 노광을 하고 구리를 에칭하여 회로를 형성하는데 Under cut 이슈로 사다리꼴 모양의 회로 형성 (Negative)
- mSAP, SAP는 극동박위에 노광을 진행하고 그 사이를 전기동도금하여 패턴을 형성하는 방법으로 직각으로 회로가 형성되어 사다리꼴보다 미세하게 회로를 형성 가능



두께	주요업체	용도	시장특징
1um~3um	일본 1개사	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PKG mSAP</li> <li>• SLP</li> </ul>	Global 독점
6um	국내 동박 대기업	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전기차 음극재</li> <li>• PCB</li> </ul>	한국 동박회사 중심
10um~	중국 중심 국내 일부	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 일반 PCB</li> </ul>	경쟁시장



- 현 4000억원의 시장으로 향후 3년 후 1조 이상의 시장규모로 성장할 전망.
- 당사는 국책과제를 시행중으로 23년 양산목표로 진행중이며, 빠르면 올해 하반기 양산목표
- mSAP, 5G (28GHz) 의 개화로 고객사와의 협업 증가, 현재 안산 6공장에 라인 셋업 완료(연 500억원 규모의 양산매출 가능)

바이오 원단



- 자체적인 마스크 브랜드 및 생활용품 출시로 시장인지도 높임
- 브랜딩 자체에 초점을 두어 사업을 진행

- 패션 분야로의 확대, 현재 글로벌 TOP 골프회사와의 협업 진행중으로 깔창, 모자 등에 제품 적용 협의중.
- 발열원단, 구스대체 소재 등 전반적인 생활필수소재 등으로 연구개발

- 바이오 분야로의 진출(관련기술은 현재 확보)
- 현재 복합창상재 시장의 진출을 위하여 대학병원과 업무추진중으로 올해 임상 예정.
- 복합창상재 (메디폼) 시장에 살균 기능을 더한 제품을 목표로 진행.